

「エポキシ樹脂市場の徹底分析」 目次

I 原料編

1. エポキシ樹脂の市場規模
 - 1.1 市場動向
 - 1.2 市場規模
 - 1.3 需要予測
2. エポキシ樹脂の分類
 - 2.1 エポキシ樹脂の品種別化学構造
 - 2.2 エポキシ樹脂硬化剤
 - (1) 硬化剤の種類と用途
 - (2) 硬化剤の需要量
 - (3) エポキシ樹脂硬化剤メーカーと銘柄
3. 主要エポキシ樹脂メーカーの展開
 - 3.1 ジャパンエポキシレジジン
 - 3.2 DIC
 - 3.3 新日化エポキシ製造
 - 3.4 旭化成エポキシ
 - 3.5 ADEKA
 - 3.6 日本エポキシ樹脂製造
 - 3.7 アイカ工業
 - 3.8 日本化薬
 - 3.9 ダウ・ケミカル日本
 - 3.10 長春人造樹脂
 - 3.11 南亜塑料工業
 - 3.12 藍星集団
 - 3.13 大連斉化化工
4. エポキシ樹脂業界の再編
5. 生産能力
 - 5.1 国内のエポキシ樹脂メーカーの生産能力
 - 5.2 世界のエポキシ樹脂メーカーの生産能力
6. エポキシ樹脂メーカーと製品
7. エポキシ樹脂用原料
 - 7.1 ビスフェノール A
 - 7.2 エピクロルヒドリン
 - 7.3 ビスフェノール F
8. 主要フォーミュレーターの概要
 - 8.1 荒川化学工業
 - 8.2 稲畑産業
 - 8.3 京セラケミカル
 - 8.4 共栄社化学
 - 8.5 コニシ
 - 8.6 サンユレック
 - 8.7 新日鐵化学
 - 8.8 信越化学工業
 - 8.9 坂本薬品工業
 - 8.10 スリーボンド
 - 8.11 住友ベークライト
 - 8.12 セメダイン
 - 8.13 ダイセル化学工業
 - 8.14 ダイセル・サイテック
 - 8.15 寺田
 - 8.16 DIC
 - 8.17 ソマール
 - 8.18 ナガセケムテックス
 - 8.19 ナミックス
 - 8.20 日東電工
 - 8.21 日本合成化工

- 8.22 パナソニック電工
- 8.23 日立化成工業
- 8.24 ファインポリマーズ
- 8.25 ベルノックス
- 8.26 明電ケミカル
- 8.27 森六ケミカルズ
- 8.28 利昌工業
- 8.29 菱電化成

II 製品市場編

1. 電気・電子部品用途

1.1 電気・電子部品用封止材料

- 1.1.1 樹脂封止材料
- 1.1.2 セラミック封止材料
- 1.1.3 封止材料参入企業と製品
- 1.1.4 電子部品用パッケージ名称と機能
 - (1) 挿入型
 - (2) 表面実装型
- 1.1.5 半導体・電子部品封止材料

1.2 半導体封止用エポキシ材料

- 1.2.1 モールドコンパウンドと成形方法
- 1.2.2 モールディングコンパウンドメーカーの生産

能力

- 1.2.3 モールディングコンパウンドの市場規模
- 1.2.4 半導体市場
- 1.2.5 半導体封止メーカーの概要と製品
 - (1) 住友ベークライト
 - (2) 日東電工
 - (3) 日立化成工業
 - (4) 信越化学工業
 - (5) 京セラケミカル
 - (6) パナソニック電工

1.3 半導体封止材用の充填材料

- 1.3.1 半導体用エポキシ封止材料の配合例
- 1.3.2 封止材用充填材料
 - (1) フィラーの種類と要求特性
 - (2) 充填剤の表面処理と表面処理剤
 - (3) 珪石の原料事情
 - (4) 輸入白珪石
 - (5) 珪石粉(生粉)
 - (6) 封止材料向け珪石製品
- 1.3.3 シリカ材料の表面処理(シランカップリング

剤)

- (1) 半導体封止材
- (2) ガラス繊維
- (3) シーリング材
- (4) タイヤ材
- (5) 架橋ポリエチレン

1.4 液状エポキシ樹脂封止材

- 1.4.1 液状エポキシ封止材の概要
- 1.4.2 市場規模
- 1.4.3 液状エポキシ封止材メーカーと製品

1.5 電子回路基板

- 1.5.1 電子回路基板の分類
- 1.5.2 電子回路基板の種類
- 1.5.3 組成による分類

- 1.5.4 電子回路用途別材料
- 1.5.5 電子回路基板の生産推移
- 1.5.6 電子回路基板メーカー 68 社の概要
- 1.6 LED
 - 1.6.1 LED の市場動向
 - 1.6.2 LED 封止材の市場規模
 - 1.6.3 LED 封止材の参入メーカー
 - 1.6.4 LED パッケージ
 - 1.6.5 LED の市場規模
 - (1) LED の用途
 - (2) LED の市場規模
 - 1.6.6 素材別 LED パッケージメーカーと製品
- 1.7 アンダーフィル材
 - 1.7.1 アンダーフィル材の概要
 - 1.7.2 アンダーフィル材の市場規模
 - 1.7.3 アンダーフィル材メーカーと製品
- 1.8 ダイボンドペースト・フィルム
 - 1.8.1 ダイボンドペースト・フィルムの概要
 - 1.8.2 ダイボンドペースト・フィルムの市場規模
 - 1.8.3 ダイボンディング材料メーカーと製品
- 1.9 導電性材料
 - 1.9.1 導電性材料の種類と要求特性
 - 1.9.2 導電性材料の市場規模
 - (1) 導電性接着剤（ペースト）
 - (2) 導電性塗料
 - 1.9.3 導電性塗料ペーストの接着剤・塗料メーカーと製品
- 1.10 UV 硬化性樹脂
 - 1.10.1 UV 硬化性樹脂の市場動向
 - 1.10.2 エポキシアクリレートオリゴマー
 - 1.10.3 UV 硬化樹脂の特長
 - 1.10.4 UV 硬化性樹脂の市場規模
 - 1.10.5 UV・EB 硬化用オリゴマー参入企業
 - 1.10.6 UV 硬化材料メーカーと製品
 - 1.10.7 UV インキメーカー
- 1.11 その他電子部品の動向
 - 1.11.1 抵抗器
 - 1.11.2 コンデンサ
 - (1) 用途による分類
 - (2) コンデンサの種類とメーカー
 - 1.11.3 変圧器、コイル

- 1.11.4 電子デバイス
- 1.11.5 ハイブリッド IC
- 1.11.6 水晶デバイス
- 1.11.7 電気・電子向けのエポキシ配合樹脂の用途別需要量
 - 1.11.8 電子部品用エポキシ樹脂メーカーと製品
- 2. その他の製品
 - 2.1 繊維強化材料
 - 2.1.1 カーボンファイバー
 - (1) カーボンファイバーの種類と用途
 - (2) 原糸形態別の分類
 - (3) カーボンファイバーのメーカー生産能力
 - (4) カーボンファイバーの国内出荷量推移
 - (5) カーボンファイバーの事業形態とプリプレグ
 - (6) プリプレグ用樹脂
 - 2.1.2 グラスファイバー
 - (1) FRP
 - (2) FRP の用途と樹脂使用状況
 - 2.2 エポキシ樹脂系接着剤
 - 2.2.1 需要動向
 - 2.2.2 エポキシ樹脂系接着剤の市場規模
 - 2.2.3 エポキシ樹脂系接着剤メーカーと製品
 - 2.3 エポキシ樹脂塗料
 - 2.3.1 種類と特徴
 - 2.3.2 エポキシ樹脂塗料の生産動向
 - 2.3.3 粉体塗料
 - 2.3.4 粉体塗料の需給動向

III 中国のエポキシ樹脂市場編

- 1. 中国のエポキシ樹脂生産能力
 - 1.1 中国のエポキシ樹脂メーカーと生産能力
 - 1.2 日系フォーミュレーター中国進出
 - 1.3 その他のメーカー
- 2. エポキシ樹脂需給バランスシート
- 3. エポキシ樹脂需要動向
 - 3.1 エポキシ樹脂需要量（中国）
 - 3.2 エポキシ樹脂輸出入動向
 - 3.3 中国及び香港の輸入、輸出統計
- 4. 主要需要先